

2024年度 第4四半期 決算説明資料

2025.4.17

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

売上高

3,933 億円

前年 3,075 億円

過去最高

GP率

70.6 %

前年 67.8%

過去最高

営業利益

1,668 億円

前年 1,214 億円

過去最高

利益率

42.4 %

前年 39.5 %

過去最高

CAPEX

698 億円

前年 165 億円

R&D

316 億円

前年 273 億円

総資産

6,540 億円

前年 5,560 億円

4年累計経常利益率

40.0 %

前年 37.0 %

FCF

523 億円

前年 811 億円

ROE

27.6 %

前年 22.4 %

過去最高

EPS

1,143.26 円

前年 777.29 円

過去最高

年間配当

1株当たり

413 円

前年 307 円

過去最高

(単位：百万円)	FY2024 4Q
売上高	120,716
売上総利益	84,218
GP率	69.8%
販売管理費	32,482
営業利益	51,735
経常利益	51,863
経常利益率	43.0%
税前利益	51,504
純利益	38,638

FY2024 3Q	QoQ	
	差額	(%)
93,553	27,163	29.0%
66,622	17,596	26.4%
71.2%	-1.4p	-
27,476	5,006	18.2%
39,145	12,590	32.2%
42,027	9,836	23.4%
44.9%	-1.9p	-
41,866	9,638	23.0%
31,809	6,829	21.5%

FY2023 4Q	YoY	
	差額	(%)
104,299	16,418	15.7%
71,324	12,894	18.1%
68.4%	1.4p	-
25,197	7,286	28.9%
46,127	5,608	12.2%
46,666	5,198	11.1%
44.7%	-1.7p	-
46,453	5,051	10.9%
35,425	3,213	9.1%

売上高： YoY 高水準の出荷と検収の進捗により増加
 GP率： YoY 高付加価値製品の寄与および為替影響により上昇
 販売管理費： YoY 人件費や研究開発費を中心に増加

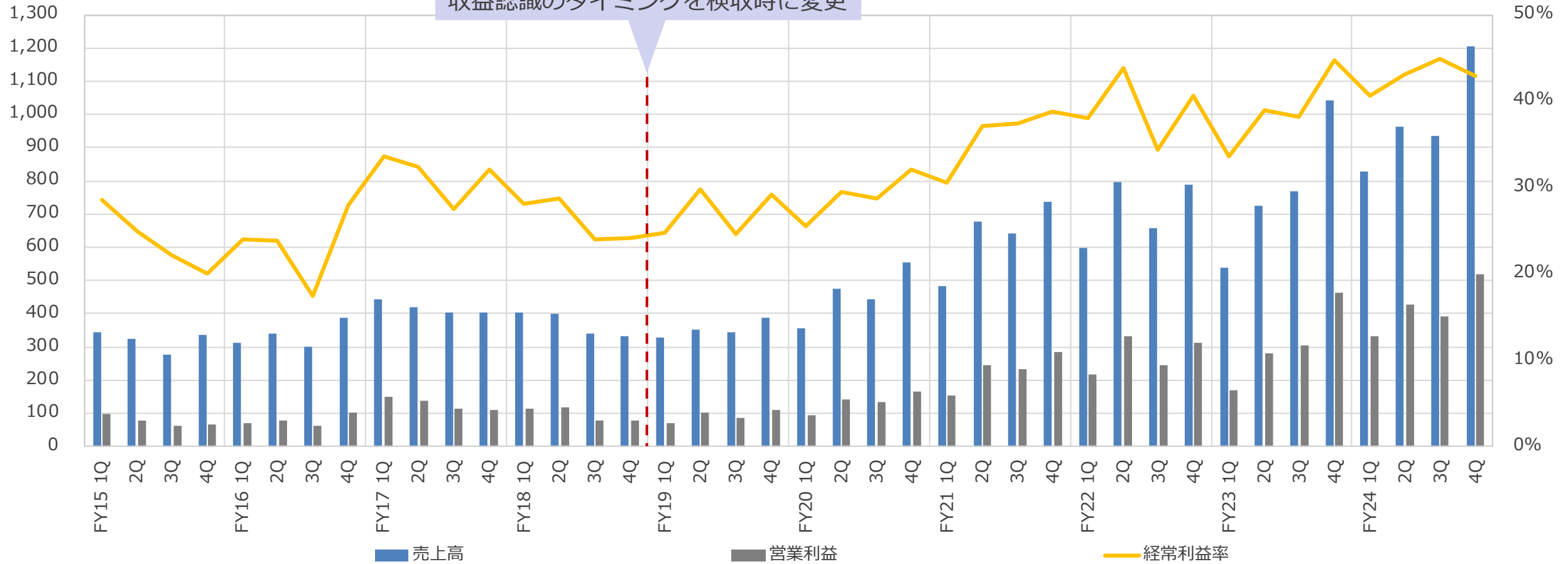
(単位：百万円)	FY2024 Full Year	FY2023 Full Year	YoY	
			差額	(%)
売上高	393,313	307,554	85,759	27.9%
売上総利益	277,570	208,642	68,928	33.0%
GP率	70.6%	67.8%	2.8p	-
販売管理費	110,736	87,151	23,585	27.1%
営業利益	166,834	121,490	45,343	37.3%
経常利益	168,943	122,393	46,550	38.0%
経常利益率	43.0%	39.8%	3.2p	-
税 前 利 益	168,146	114,576	53,570	46.8%
純 利 益	123,891	84,205	39,685	47.1%

売上高： 生成AI向けなどで装置の出荷増・検収進捗により増収

GP率： 高付加価値案件や為替恩恵で上昇し高水準

販売管理費： 人件費や研究開発費を中心に増加

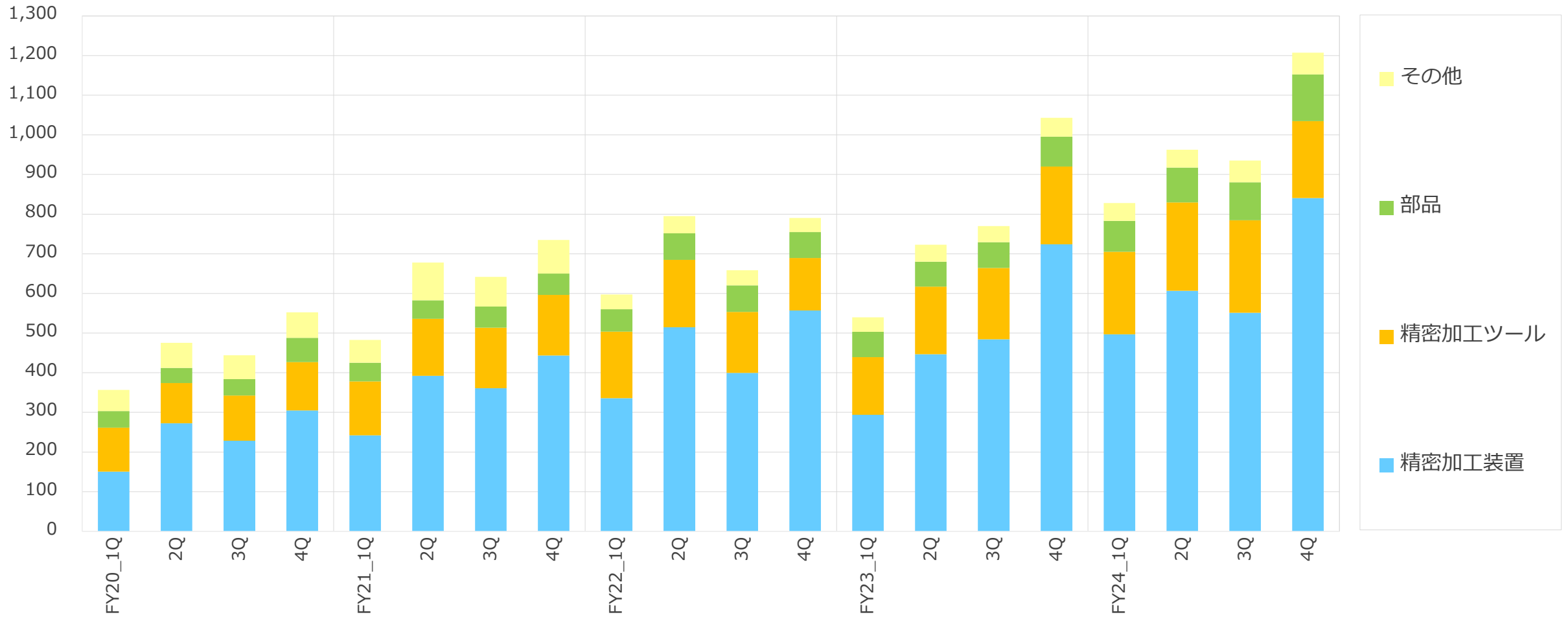
(単位：億円)



売上高・各利益は四半期最高を記録
(FY24_4Q 営業利益率42.9% 経常利益率43.0% 純利益率32.0%)

製品群別売上高 四半期推移

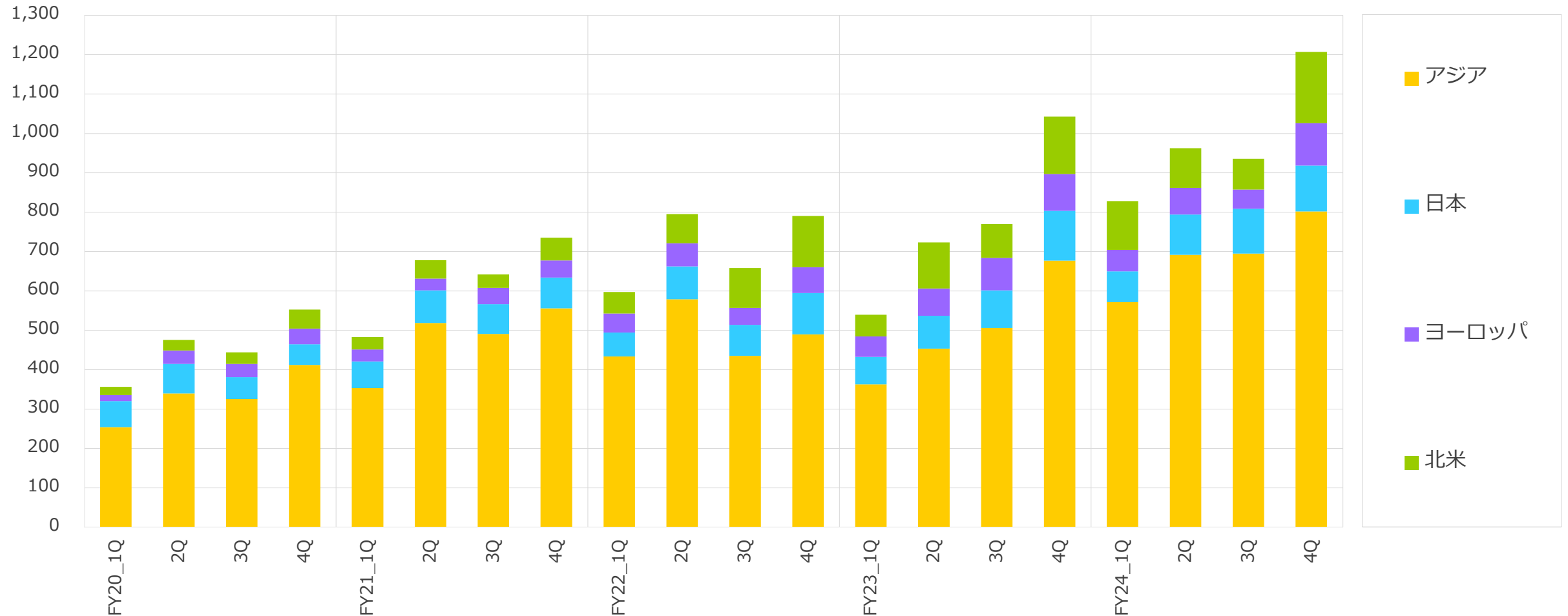
(単位：億円)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

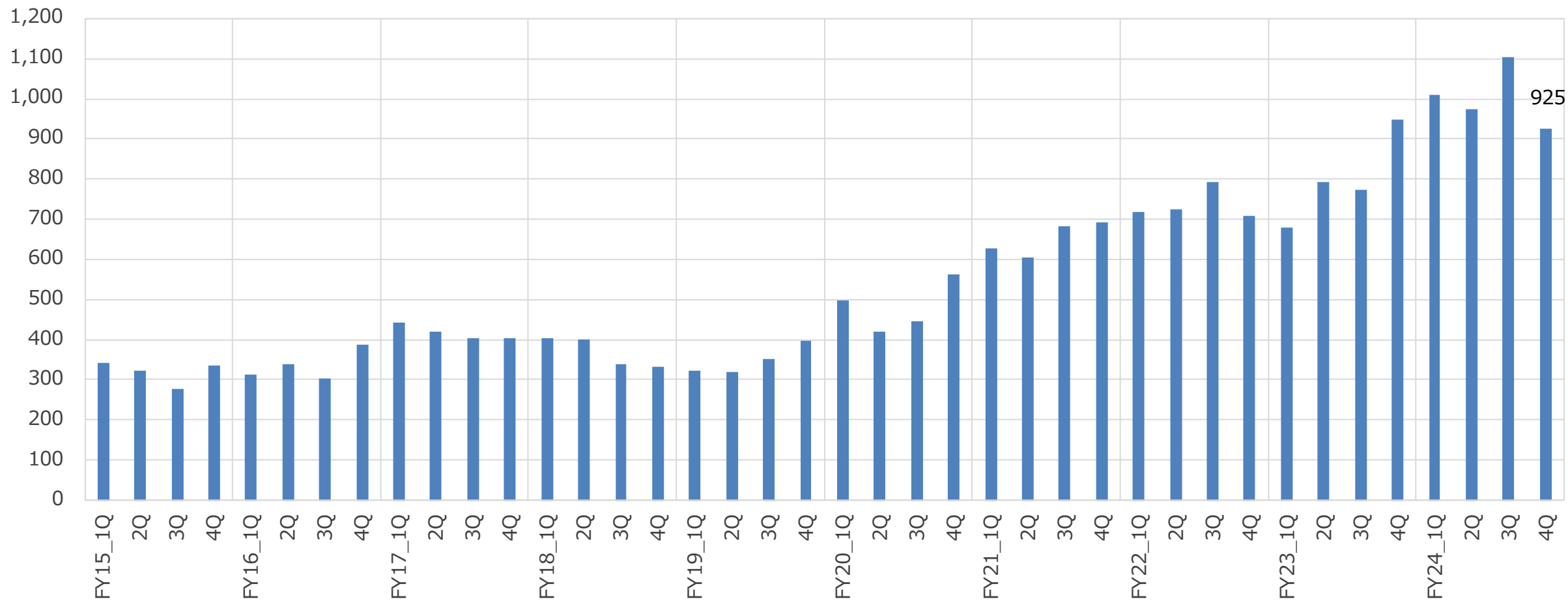
地域別売上高 四半期推移

(単位：億円)



FY24_4Q 海外売上高比率 90.4%

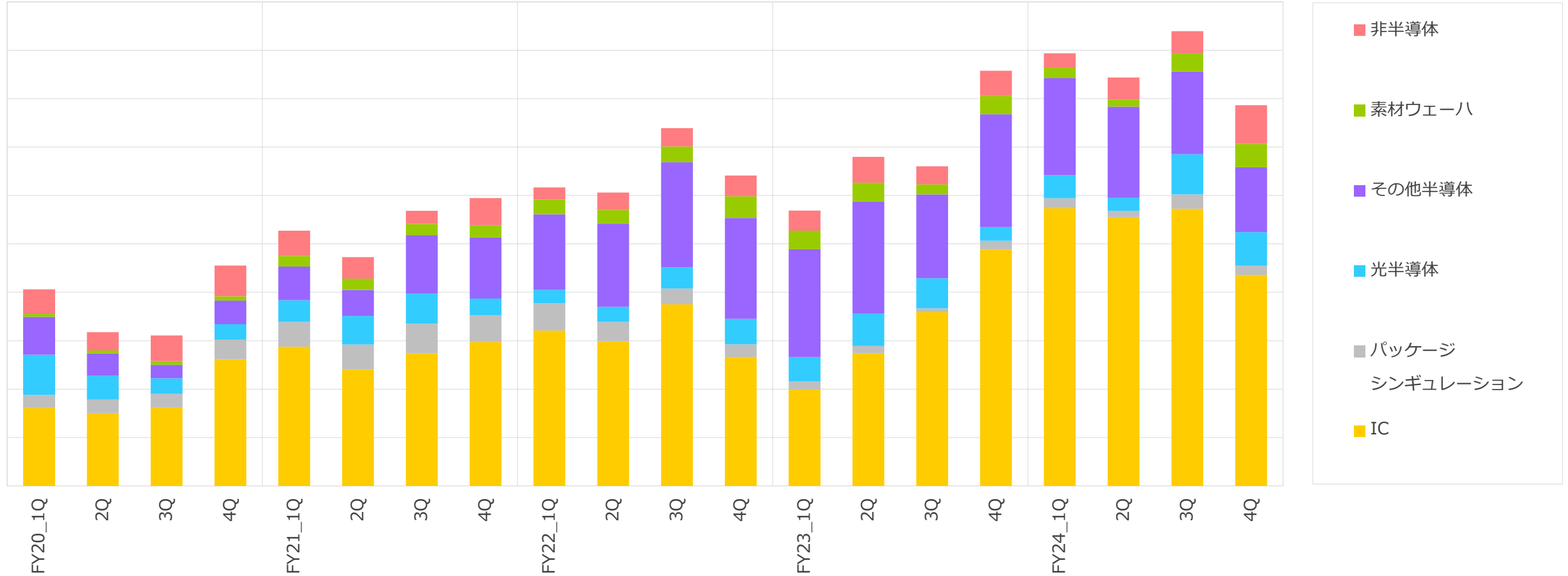
(単位：億円)



FY24_4Q 出荷額 約925億円

出荷額ベース

精密加工装置

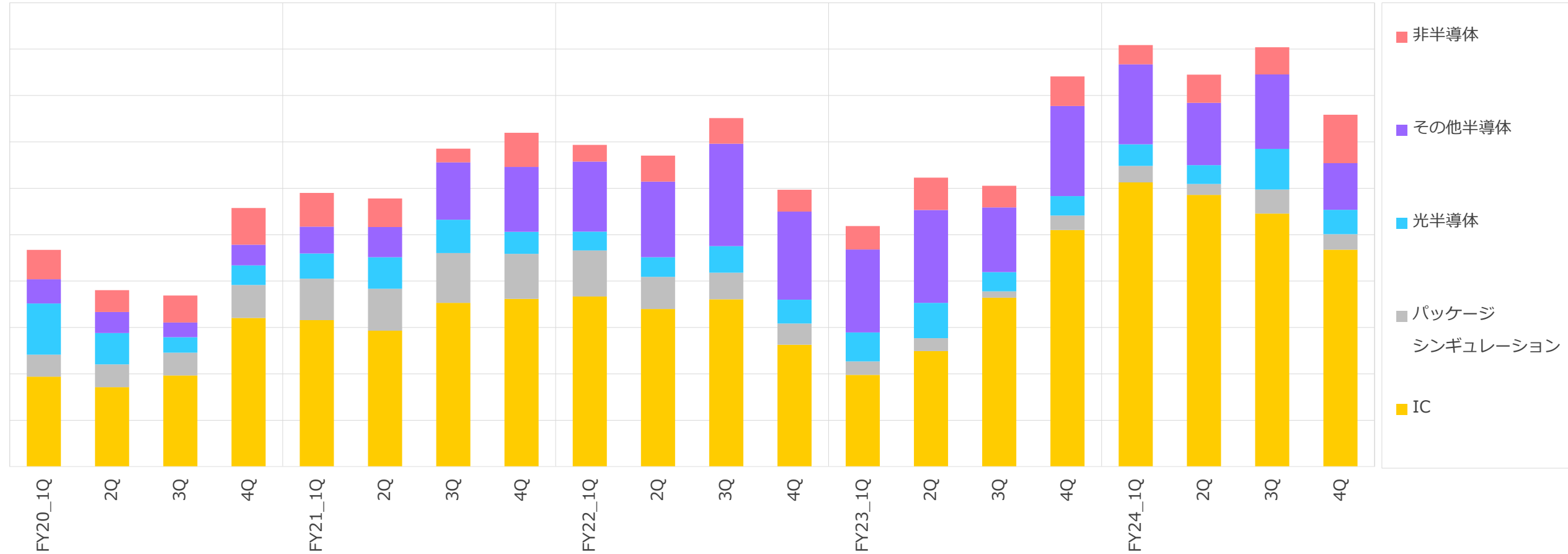


QoQ
YoY

非半導体向けが増加するも、IC向けの減少が全体を押し下げた
EV需要の減速などによりパワー半導体向けが減少

出荷額ベース

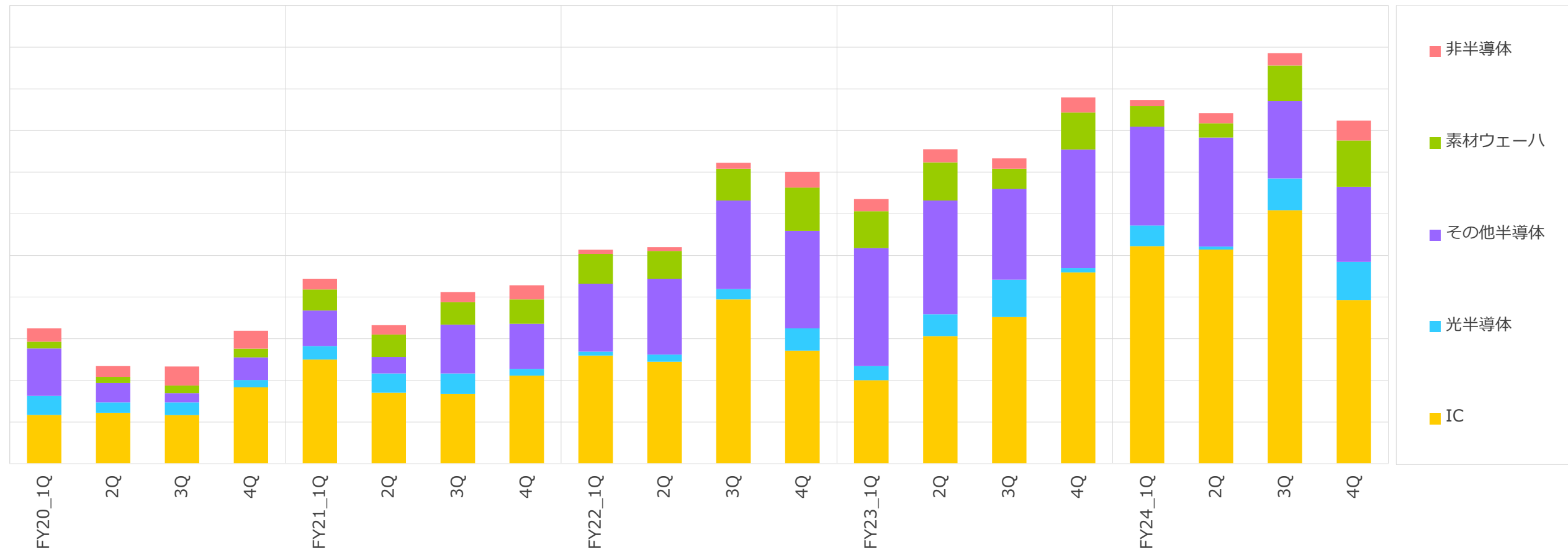
ダイサ



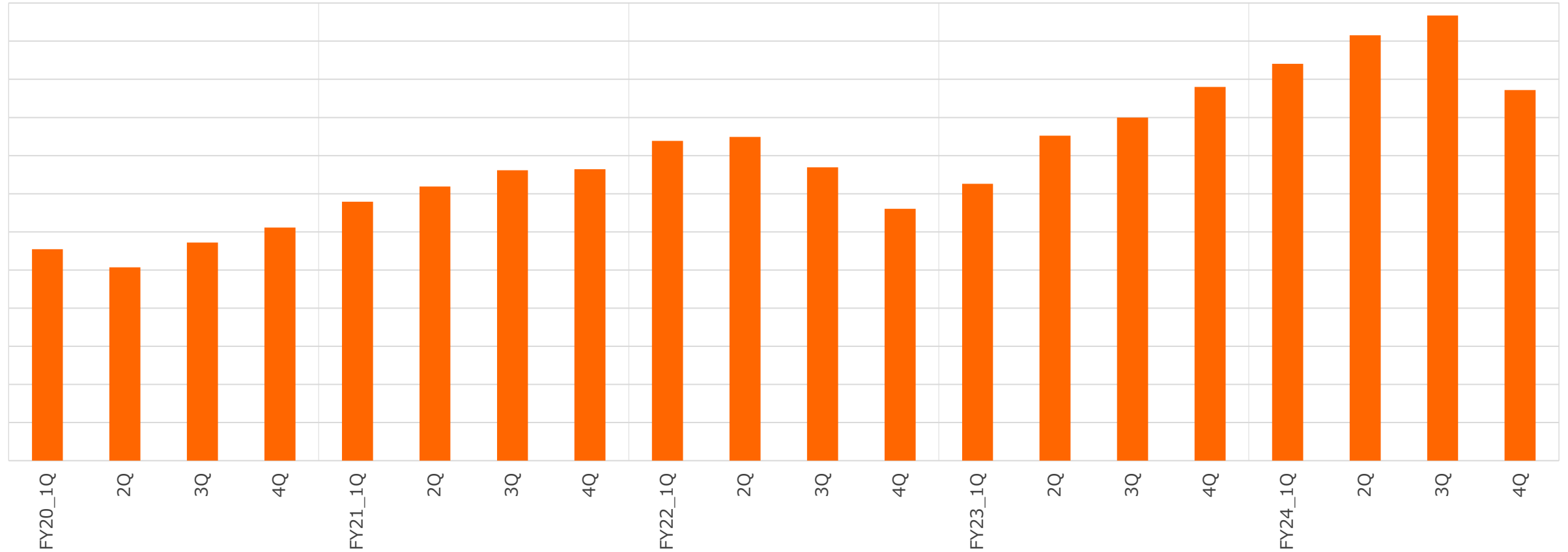
QoQ メモリとパワー半導体向けが減少
 YoY EV需要の減速などによりパワー半導体向けが減少

出荷額ベース

グラインダ



QoQ 素材ウェーハ、非半導体向けが増加も、IC向けの減少が全体を押し下げた
 YoY パワー半導体は減少するも、光半導体と素材ウェーハの増加が全体を下支え



精密加工ツール（消耗品）の出荷は季節性などにより減少

(単位：百万円)	FY2024 4Q	FY2024 3Q	差額
現金及び預金	229,167	263,487	-34,320
受取手形・売掛金	43,178	42,702	477
棚卸資産	139,002	140,858	-1,856
流動資産	424,502	456,405	-31,904
有形固定資産	204,014	151,687	52,327
固定資産	229,585	172,381	57,204
総資産	654,087	628,786	25,300
流動負債	160,392	173,871	-13,479
固定負債	991	821	170
負債合計	161,383	174,692	-13,309
純資産	492,703	454,093	38,609
負債純資産合計	654,087	628,786	25,300
自己資本比率	75.1%	72.0%	3.1p

総資産：主に有形固定資産が増加

負債：主に契約負債（流動負債内）が減少

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：百万円)	FY2024 Full Year	FY2023 Full Year	差額
営業キャッシュ・フロー	120,364	97,524	22,840
税前当期利益	168,146	114,576	53,570
減価償却	12,198	11,031	1,168
売上債権の増減	2,874	-2,650	5,525
棚卸資産の増減	-24,596	-22,226	-2,370
仕入債務の増減	-4,795	9,591	-14,387
法人税支払い	-37,738	-31,600	-6,138
その他営業CF	4,276	18,803	-14,527
投資キャッシュ・フロー	-68,002	-16,403	-51,599
有形固定資産の取得	-66,861	-16,140	-50,721
フリー・キャッシュ・フロー	52,362	81,120	-28,759
財務キャッシュ・フロー	-38,150	-30,938	-7,212
配当金支払い	-38,467	-31,115	-7,352
現金同等物増減	13,680	52,433	-38,753
期首残高	215,486	163,053	52,433
期末残高	229,167	215,486	13,681

●営業CF・・・約1,203億円 資金増加
主に税前利益による資金増加

●投資CF・・・約680億円 資金減少
主に有形固定資産の取得によるもの

●フリー・キャッシュ・フロー
約523億円の資金増加

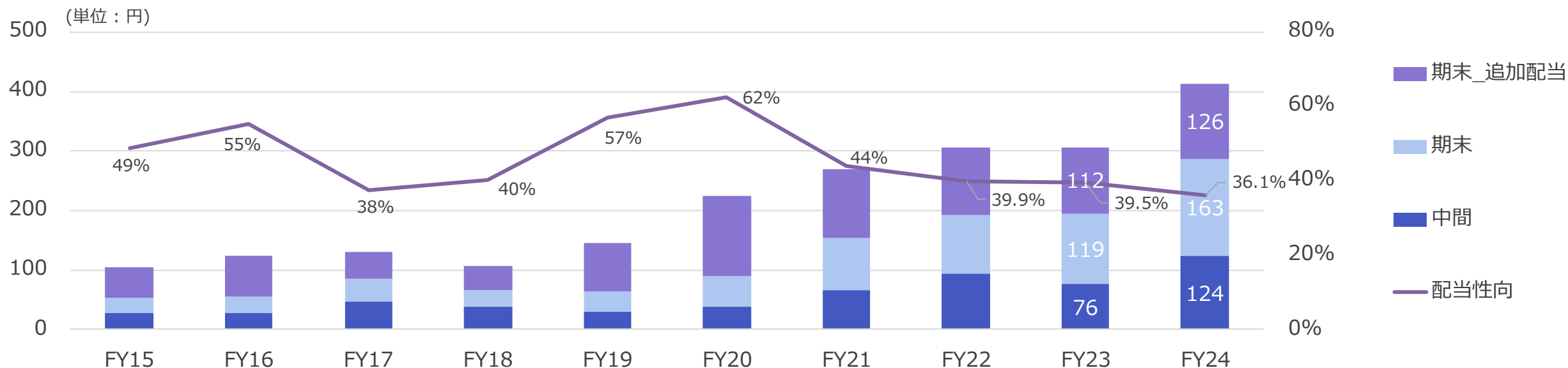
●財務CF・・・約381億円 資金減少
主に配当金の支払い

→ 3月末の現金残高 約2,291億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

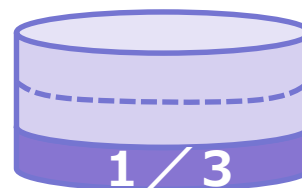
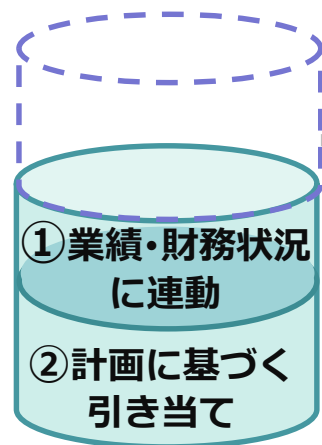
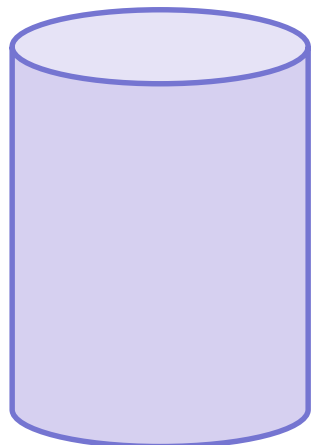
*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY24 実績 中間：124円 期末：289円 年間：413円（過去最高）

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
 (FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載)

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{年度末現預金} \\ \hline \text{1,684億円} \quad \text{※1} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{必要資金} \\ \hline \text{1,278億円} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{余剰資金} \\ \hline \text{406億円} \\ \hline \end{array}$$



135億円

追加配当

必要資金の内訳

①	運転資金 <small>前期連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月</small>	655 億円
	技術購入予備費(M&A含む) <small>連結売上高過去3年平均 × 10%</small>	280 億円
	長期有利子負債返済資金	-
	税金・配当等	368 億円
②	設備拡張資金 <small>羽田R&Dセンター建替等</small>	225 億円
③	技術購入予備費の取り崩し <small>※2</small>	▲250 億円

※1 契約負債（前受金）金額などを考慮

※2 研究開発用不動産の購入に伴い技術購入予備費を取り崩し

(単位：億円)

今回予想

	FY24 1Q	2Q	3Q	4Q	FY25 1Q
売上高	828	962	936	1,207	750
営業利益	334	426	391	517	238
経常利益	336	414	420	519	238
純利益	237	297	318	386	167
営業利益率	40.3%	44.2%	41.8%	42.9%	31.7%
経常利益率	40.6%	43.0%	44.9%	43.0%	31.7%
純利益率	28.6%	30.9%	34.0%	32.0%	22.3%
出荷額	1,011	976	1,103	925	1,020

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 1Q (4-6月期)
為替感応度 (実績年間)

US\$: 135円
US\$: 約16億円

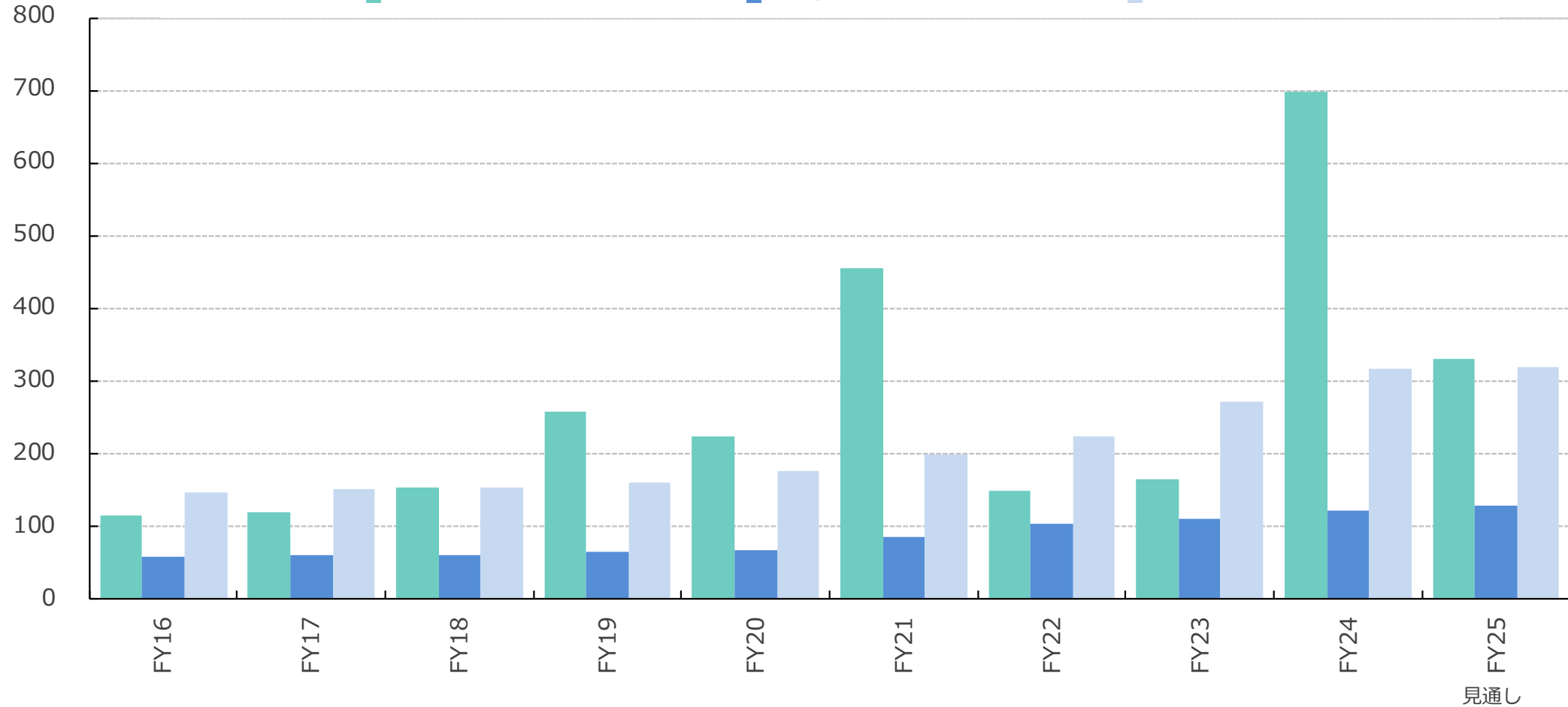
Euro : 155円
Euro : 約1億円

出荷額ベース

製品群		見通し FY25_1Q 増減率 (QoQ)
精密加工装置	ブレードダイサ	30%
	レーザーソー	20%
	ダイサ	25%
	グラインダ	15%
	周辺装置	0%
精密加工装置		20%
精密加工ツール		5%
その他		-15%

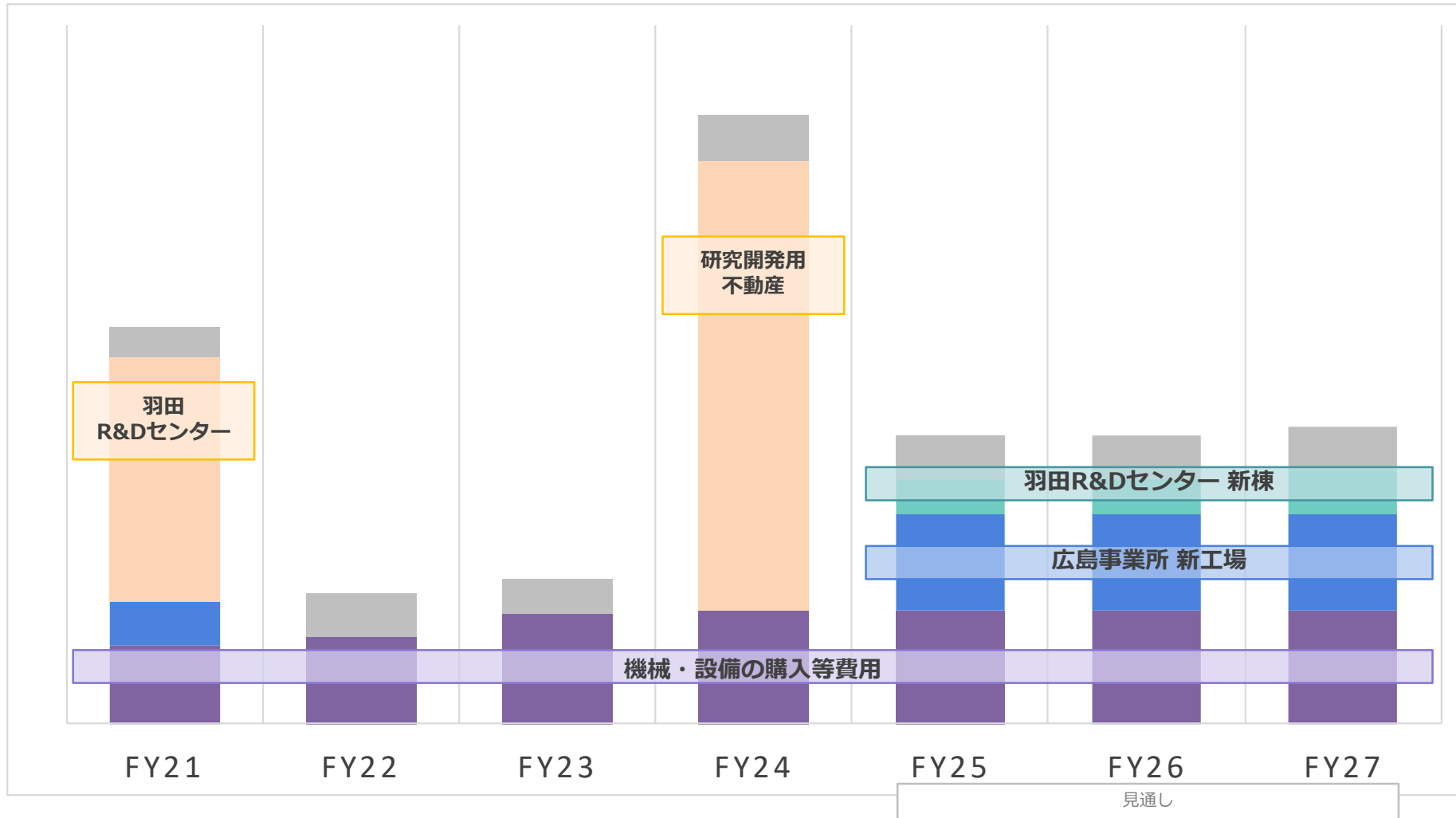
(単位：億円)

■ 設備投資 ■ 減価償却 ■ 研究開発



FY24実績 設備投資：698億円
 ※ R & D設備拡張を見据え不動産購入
 (約500億円)

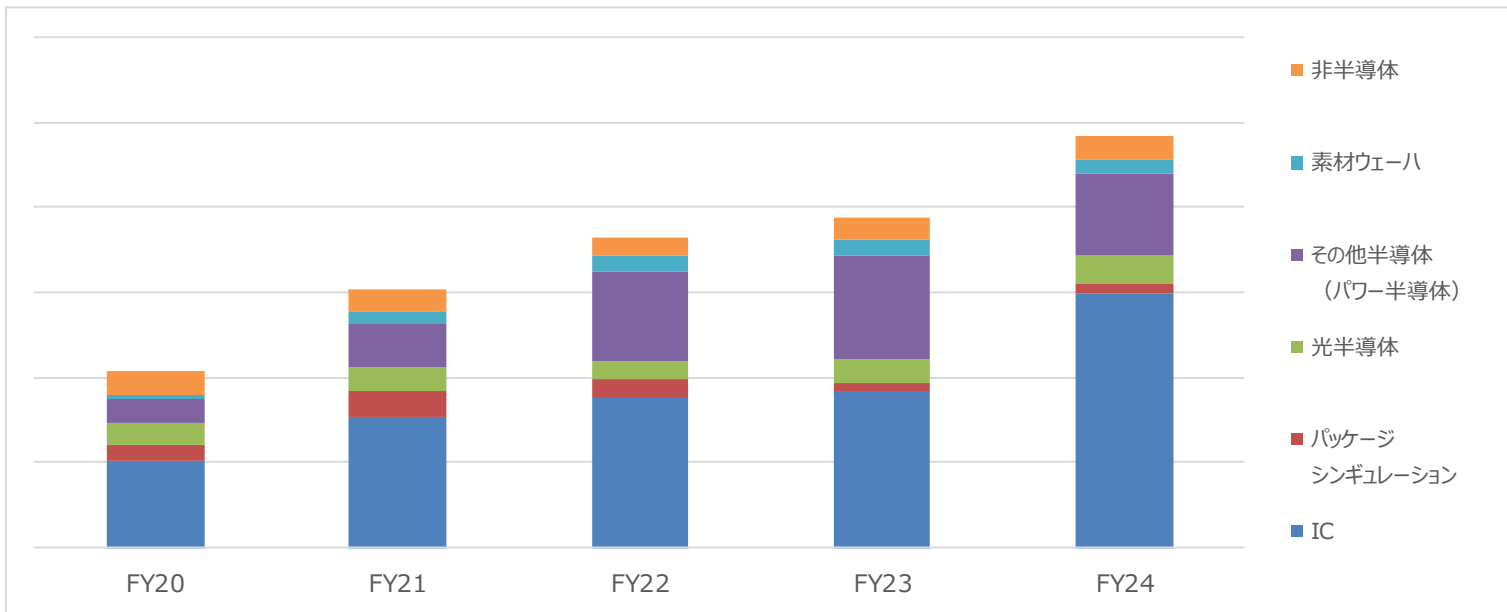
FY25見通し 設備投資：約330億円
 減価償却：約130億円
 研究開発：約320億円



研究開発用不動産	約500億円	支出時期：FY24
羽田R&Dセンター 新棟	約130億円	支出時期：FY25～FY27
広島事業所 新工場	約330億円	支出時期：FY25～FY27

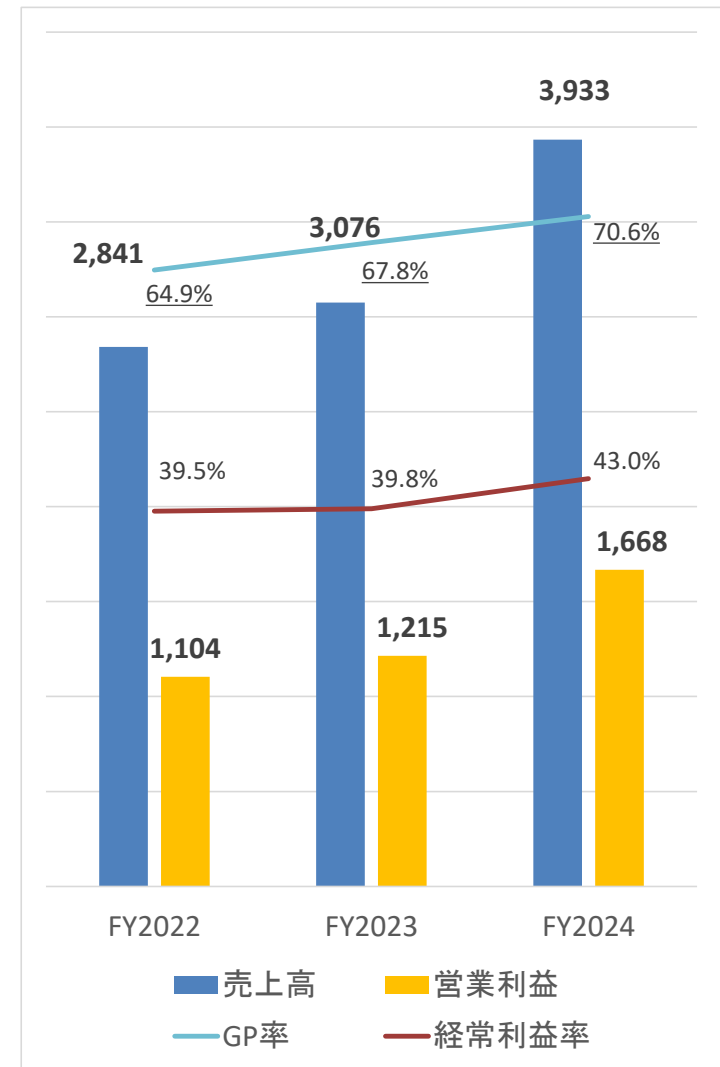
■ 出荷動向

PC・スマホ向け需要は本格回復に至らず
 パワー半導体はEVシフトの鈍化を背景に投資意欲減退
 生成AI関連の需要が継続し装置出荷が高水準で推移

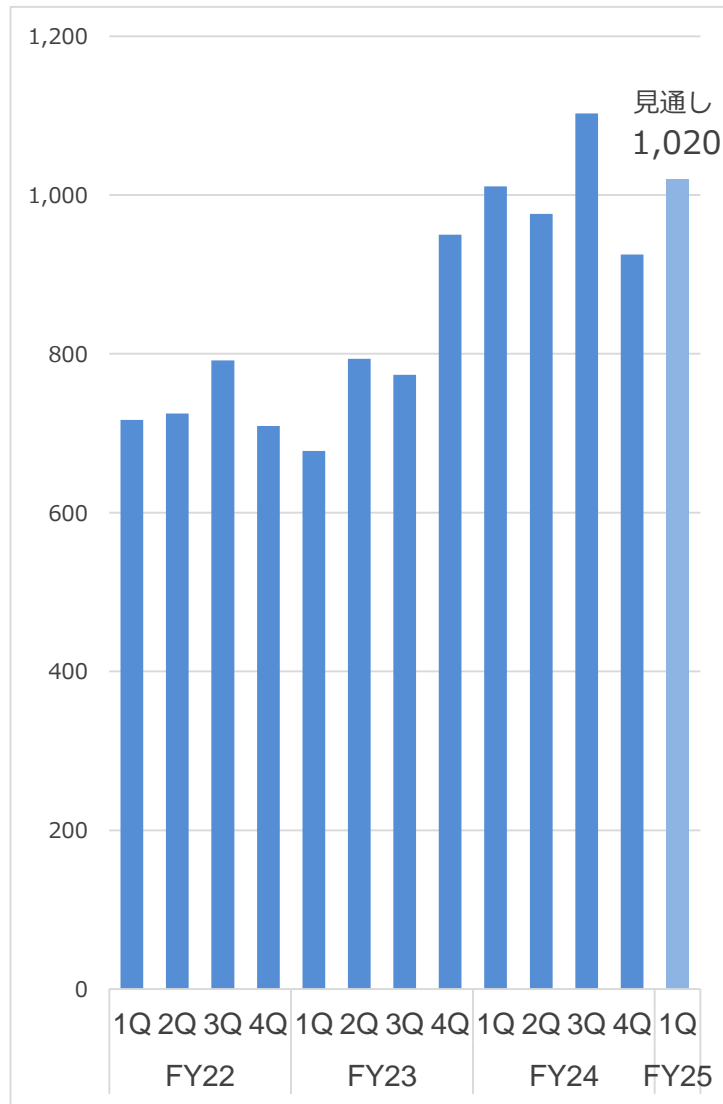


- 業績：高付加価値案件や為替恩恵で年間GP率70%台を記録
装置・消耗品ともに収益性が向上
- 将来のR&D設備拡張を見据え不動産購入を実施
- 最高益+余剰資金より年間配当413円 (過去最高)

業績推移 (検収基準) 単位：億円



出荷額 四半期推移 (億円)



- 関税政策による顧客の投資意欲・需要動向の変化を注視
 - ・量産用途の設備投資の動きは見られず
 - ・最終製品や稼働率に連動する消耗品の動向を注視

- 生成A I 向けは最終需要などに連動して装置出荷が継続

- 中長期的な半導体需要増加を見据え積極的な投資を継続
 - 羽田R&Dセンター 新棟建設 (2025年着工予定)
 - 広島事業所 新工場建設 (2026年着工予定)

- 市場の繁忙や閑散に関わらず
 - 全力で「会社を強くする」取り組みを継続
 - DISCO VALUES、Will会計、PIM活動に注力

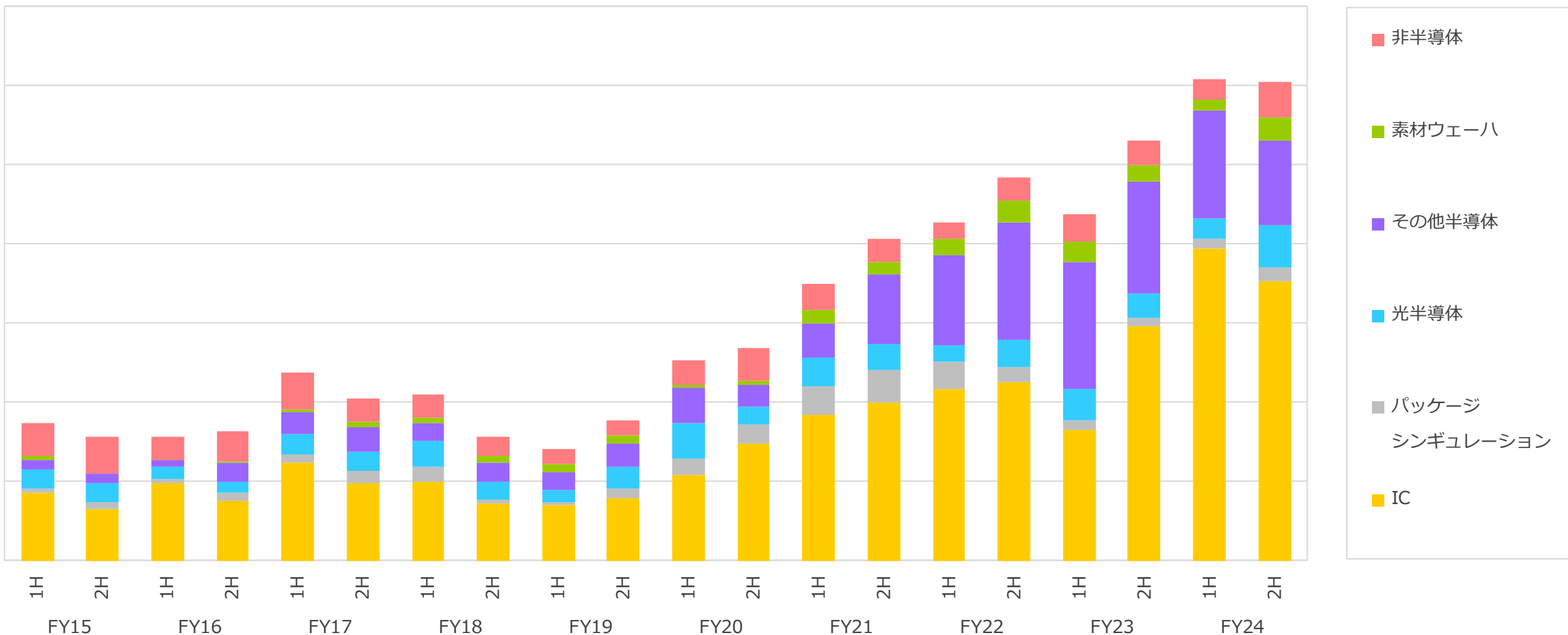
参考 半期・通期推移 グラフ集

精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

半期

精密加工装置

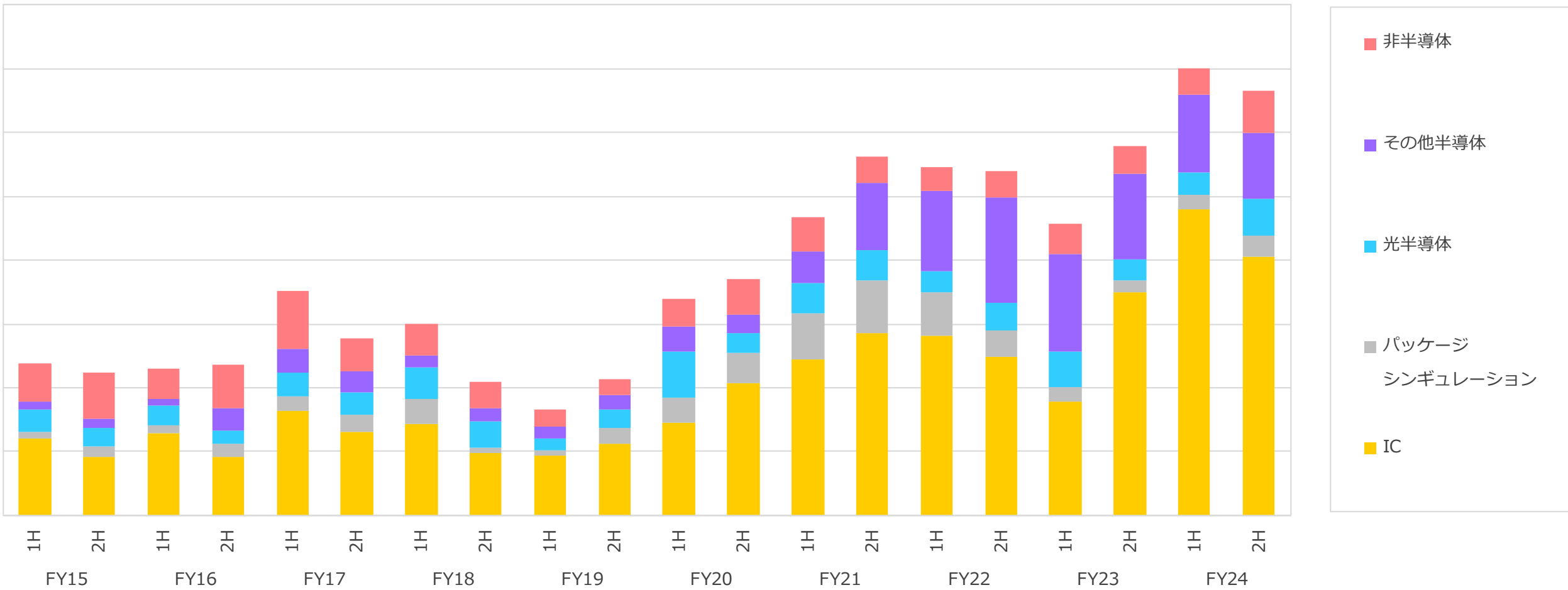


ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

半期

ダイサ

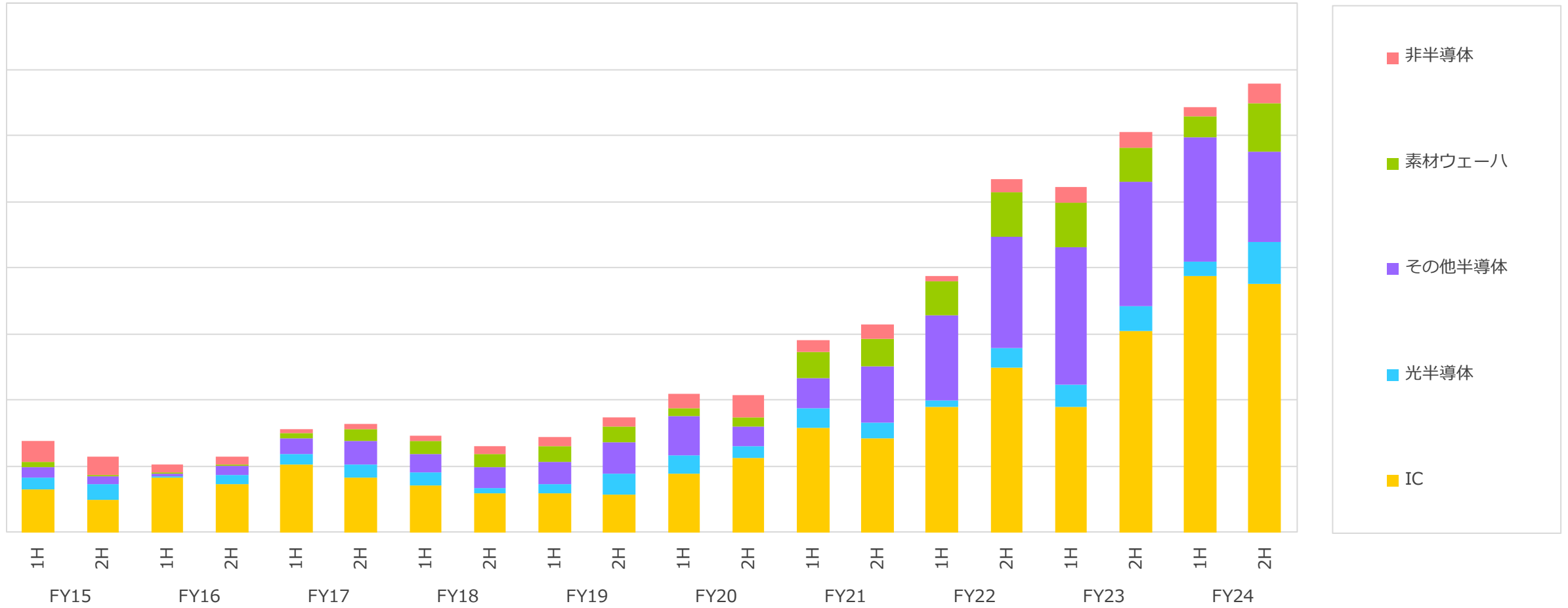


グラインダ用途別売上高

出荷額ベース

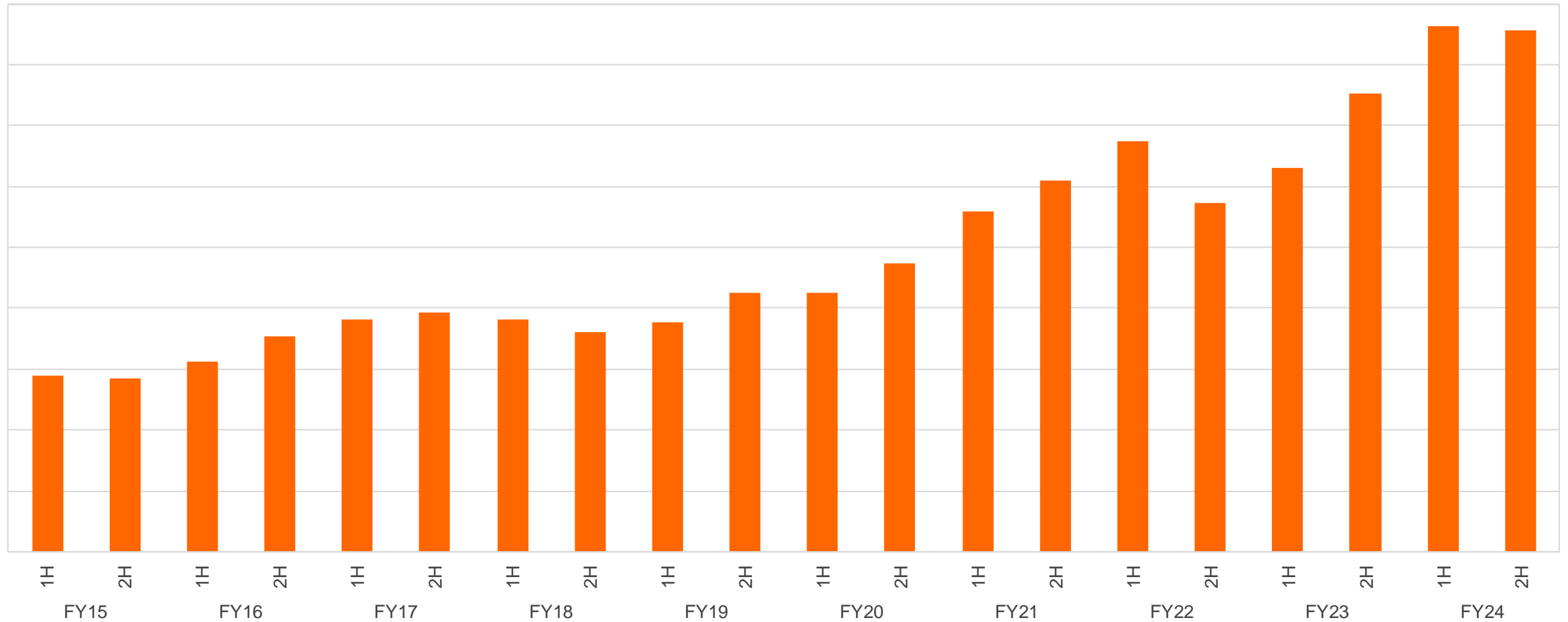
半期

グラインダ



出荷額ベース

半期

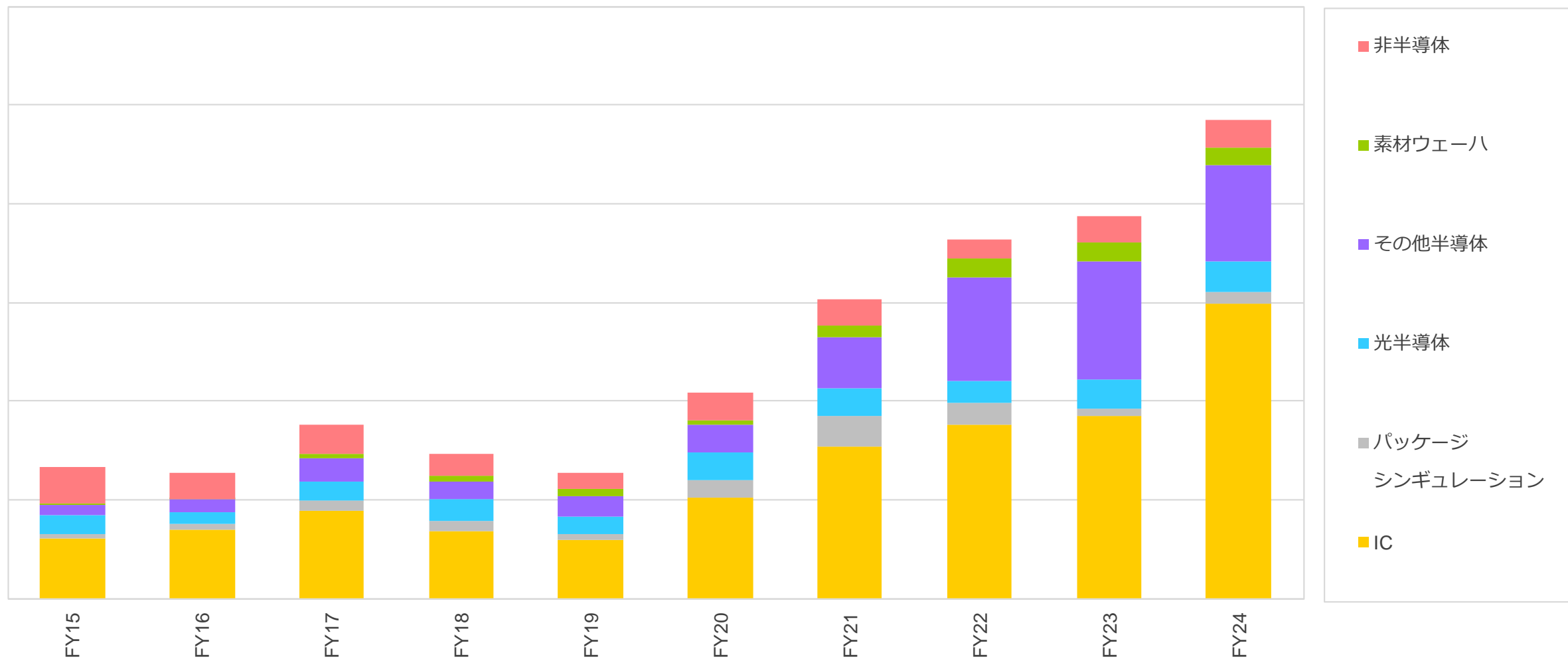


精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

通期

精密加工装置

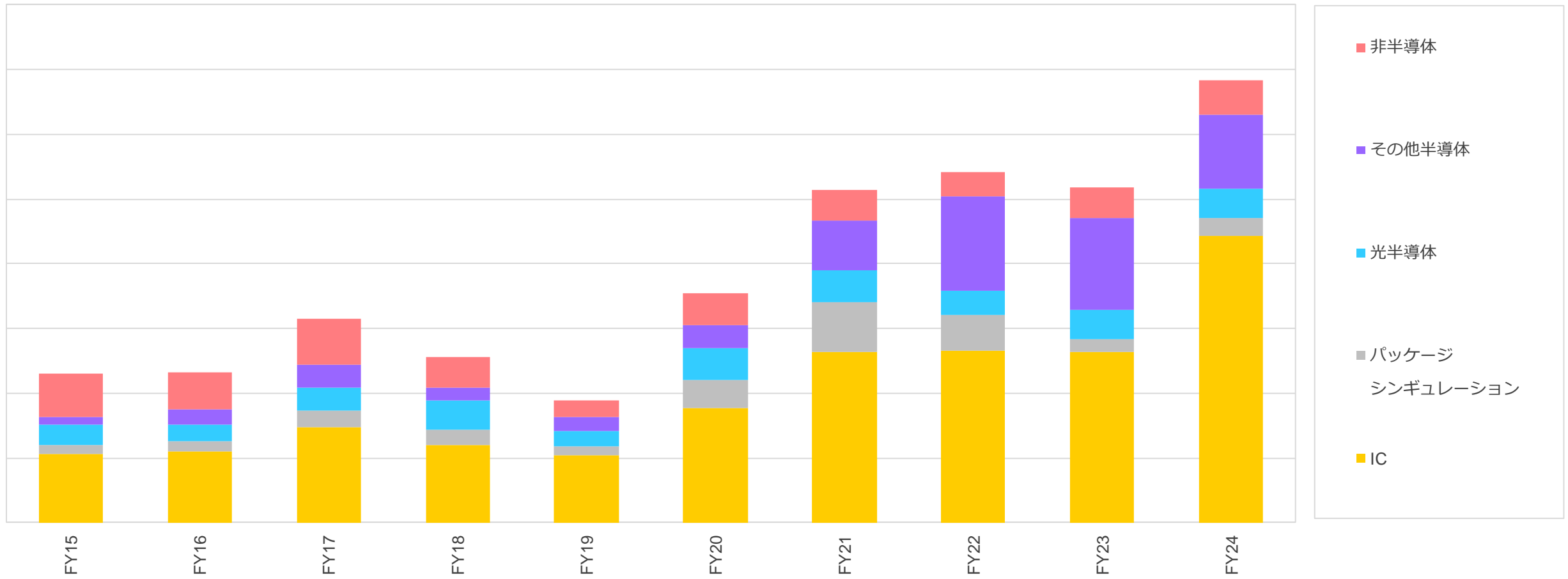


ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

通期

ダイサ

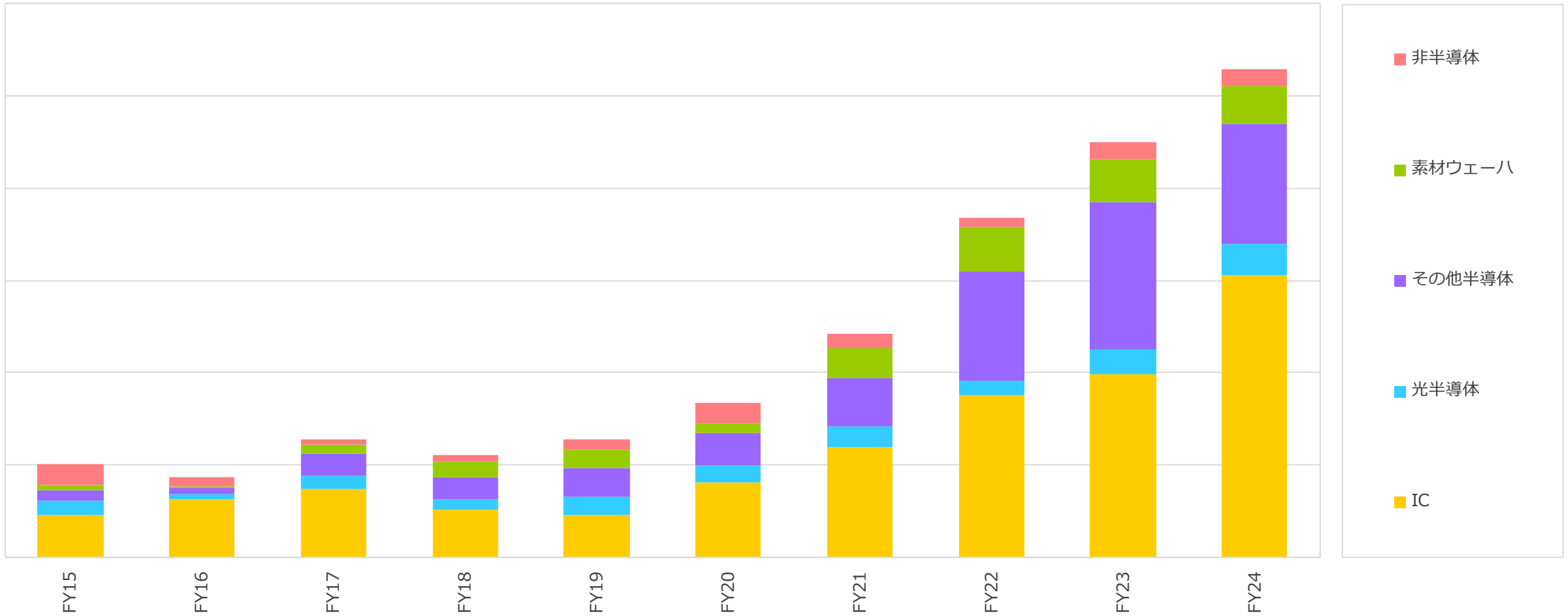


グラインダ用途別売上高

出荷額ベース

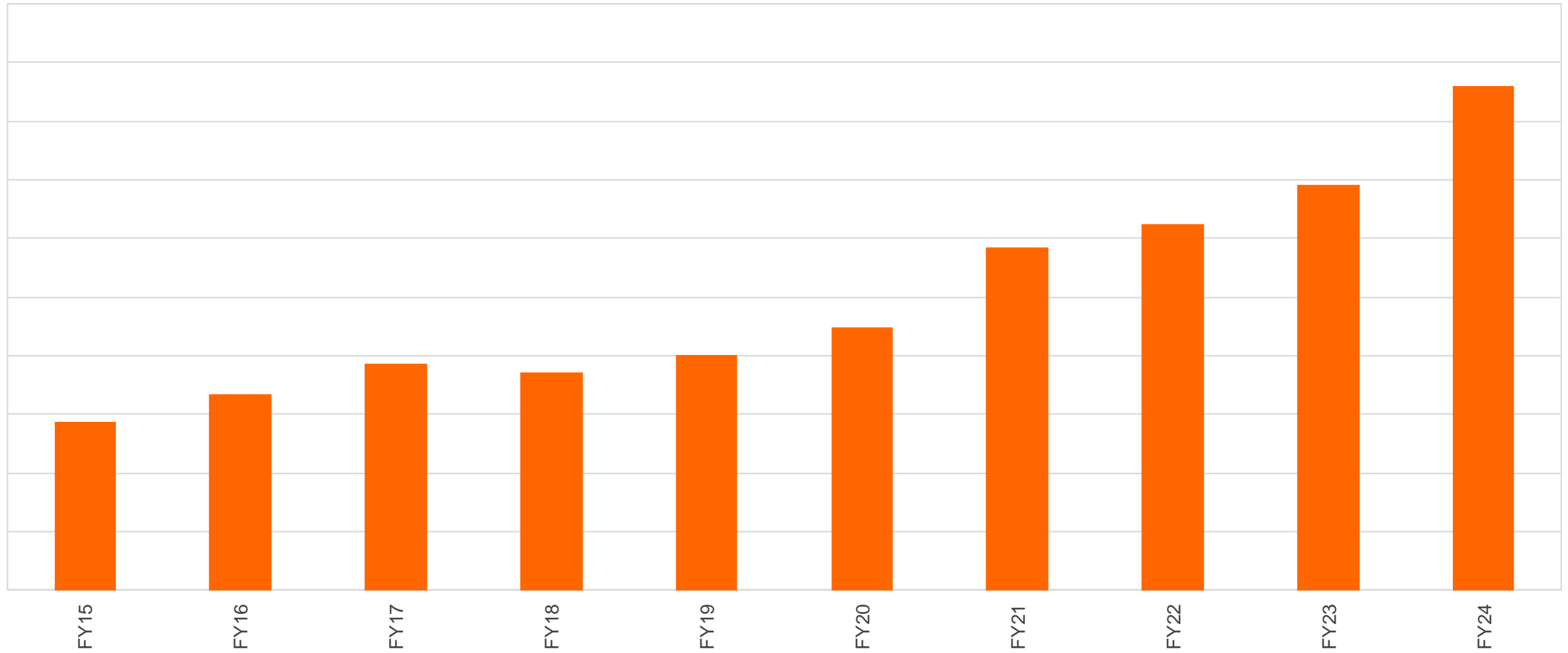
通期

グラインダ



出荷額ベース

通期



参考 製品群別・用途別 データ集

出荷額ベース

■製品群	4Q			2H		Full Year	
	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY	構成比	YoY
精密加工装置合計	64%	-15%	-6%	63%	15%	64%	26%
内、ダイサ	33%	-16%	-10%	33%	15%	34%	32%
ブレードダイサ	15%	-30%	-22%	17%	9%	17%	18%
レーザソー	18%	1%	4%	16%	22%	17%	50%
内、グラインダ	27%	-16%	-6%	27%	12%	26%	17%
薄化DGP	16%	-31%	10%	18%	36%	18%	56%
薄化以外	11%	20%	-23%	9%	-16%	9%	-22%
内、周辺装置	4%	1%	58%	4%	50%	4%	35%
精密加工ツール	21%	-15%	1%	21%	13%	22%	25%
その他	15%	-20%	7%	16%	36%	14%	27%
出荷額合計	100%	-16%	-3%	100%	18%	100%	26%

出荷額ベース

製品	用途	FY23				FY24			
		23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q
ダイサ	1_IC	38%	40%	60%	61%	67%	69%	60%	62%
	2_パッケージ・シンギュレーション	6%	4%	2%	4%	4%	3%	6%	4%
	3_光半導体	12%	12%	7%	5%	5%	5%	10%	7%
	4_その他_半導体	34%	32%	23%	23%	19%	16%	18%	13%
	5_非半導体	10%	11%	8%	8%	5%	7%	7%	14%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	32%	41%	48%	52%	60%	61%	62%	48%
	2_光半導体	5%	7%	12%	1%	6%	1%	8%	11%
	3_その他_半導体	45%	36%	30%	32%	27%	31%	19%	22%
	4_素材ウエーハ	14%	12%	7%	10%	6%	4%	9%	14%
	5_非半導体	5%	4%	3%	4%	2%	3%	3%	6%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY23				FY24			
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q
ダイサ	1_IC	-46%	-27%	1%	94%	210%	135%	50%	-8%
	2_パッケージ・シンギュレーション	-71%	-60%	-76%	-32%	23%	-15%	270%	7%
	3_光半導体	55%	81%	-28%	-18%	-26%	-46%	112%	26%
	4_その他_半導体	18%	23%	-37%	2%	-3%	-33%	15%	-48%
	5_非半導体	40%	24%	-15%	35%	-17%	-13%	26%	65%
ダイサ		-25%	-7%	-19%	41%	75%	36%	49%	-10%
グラインダ	1_IC	-23%	25%	-11%	69%	160%	68%	73%	-14%
	2_光半導体	253%	207%	267%	-81%	46%	-86%	-15%	819%
	3_その他_半導体	74%	50%	3%	22%	-16%	-4%	-15%	-37%
	4_素材ウエーハ	24%	37%	-37%	-15%	-45%	-62%	79%	26%
	5_非半導体	198%	244%	74%	-4%	-50%	-24%	19%	31%
グラインダ		24%	45%	1%	25%	37%	11%	34%	-6%

出荷額ベース

		FY23				FY24			
製品	用途	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q	24-1Q	24-2Q	24-3Q	24-4Q
ダイサ	1_IC	-25%	26%	46%	40%	20%	-4%	-7%	-14%
	2_パッケージ・シンギュレーション	-37%	-5%	-50%	126%	14%	-34%	119%	-35%
	3_光半導体	22%	22%	-46%	1%	10%	-12%	115%	-40%
	4_その他_半導体	-6%	12%	-30%	39%	-11%	-22%	19%	-37%
	5_非半導体	7%	38%	-33%	36%	-34%	46%	-3%	77%
ダイサ		-13%	20%	-3%	39%	8%	-7%	7%	-16%
グラインダ	1_IC	-26%	53%	15%	31%	14%	-2%	18%	-35%
	2_光半導体	-36%	55%	70%	-89%	402%	-85%	952%	20%
	3_その他_半導体	21%	-3%	-20%	30%	-17%	10%	-29%	-3%
	4_素材ウエーハ	-15%	3%	-48%	85%	-45%	-29%	148%	29%
	5_非半導体	-23%	8%	-21%	46%	-59%	62%	24%	61%
グラインダ		-9%	19%	-3%	20%	-1%	-4%	17%	-16%

検収ベース

■ 構成比	FY2023				FY2024			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	13%	12%	12%	12%	9%	11%	12%	10%
アメリカ	10%	16%	11%	14%	15%	10%	8%	15%
アジア	67%	63%	66%	65%	69%	72%	74%	66%
シンガポール	8%	9%	7%	6%	6%	8%	8%	7%
台湾	15%	11%	10%	12%	16%	17%	19%	22%
韓国	8%	5%	9%	12%	14%	12%	9%	9%
中国 ※	35%	36%	38%	34%	32%	33%	37%	27%
その他	1%	2%	1%	0%	1%	1%	1%	2%
ヨーロッパ	10%	10%	11%	9%	7%	7%	5%	9%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY (Fiscal Year) と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。％は実際の金額を基に算出しています。

将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>